

Anda TSV-300

Настольный оффлайн дозатор
технологических материалов для SMT



Anda TSV-300 — настольная автоматическая система дозирования, предназначенная для нанесения технологических материалов на печатные платы и электронные компоненты при производстве электроники.

Оборудование используется для точного дозирования влагозащитных покрытий, клеевых материалов, компаундов и паяльных паст при сборке электронных устройств. Система обеспечивает стабильность дозирования и точное позиционирование материала на печатных платах различных форматов.



Общее описание

Дозаторы серии Anda применяются в лабораториях разработки, на участках мелкосерийного производства и в производственных линиях сборки электроники. Управление системой осуществляется промышленным компьютером с программным обеспечением Anda и операционной системой Windows, обеспечивающими удобную настройку параметров процесса и программирование траекторий нанесения материалов.

Дозатор Anda TSV-300 применяется для выполнения операций точного нанесения технологических материалов при производстве электронных устройств.

Область применения

- покрытие влагозащитными материалами
- нанесение паяльной пасты
- дозирование клеевых материалов
- нанесение underfill-материалов
- герметизация выводов компонентов
- сборка печатных плат и электронных модулей
- нанесение технологических покрытий

Конструкция и состав системы

Дозатор TSV-300 построен на базе высокоточной системы перемещения с сервоприводами, обеспечивающими стабильность и точность позиционирования при выполнении операций дозирования.

Система оснащена CCD-камерой визуального позиционирования, позволяющей автоматически определять координаты печатной платы и корректировать программу нанесения материала.

Программирование операций осуществляется с использованием визуального программирования, что упрощает настройку технологического процесса. Конструкция оборудования предусматривает автоматическую очистку сопла и систему контроля параметров нанесения материала.

Оборудование поддерживает подключение производственных систем идентификации и может интегрироваться в автоматизированные процессы производства электроники.

Функциональные возможности

- высокоточное дозирование материалов
- визуальное позиционирование платы
- программирование траекторий нанесения
- автоматическая очистка сопла
- контроль технологических параметров дозирования
- подключение сканеров и систем идентификации
- интеграция в производственные процессы сборки электроники

Преимущества конструкции

- высокая точность и повторяемость дозирования;
- компактная настольная конструкция;
- удобное визуальное программирование;
- стабильность технологического процесса;
- возможность работы с различными технологическими материалами;
- интеграция с системами контроля производства.



Таблица технических характеристик

Таблица технических характеристик	
Параметр	Anda TSV-300
Габариты оборудования	810 × 660 × 760 мм
Масса	105 кг
Система управления	промышленный компьютер IPC и плата управления движением
Программное обеспечение	Anda Software + Windows OS
Тип программирования	визуальное программирование
Количество осей	X, Y, Z
Привод осей	сервопривод
Рабочая зона	X: 260 мм; Y: 260 мм; Z: 100 мм
Количество клапанов	1 (стандартная конфигурация)
Максимальная скорость перемещения	800 мм/с
Повторяемость	±0,025 мм
Ёмкость материала	30 cc
Очистка сопла	вакуумная
Система сигнализации	меню, звуковая и световая сигнализация
Контроль нанесения покрытия	автоматический
Питание	220 В, 50/60 Гц
Требуемое давление воздуха	≥ 0,65 МПа
Потребляемая мощность	1,3 кВт
Соответствие стандартам	CE
Стандартные функции	CCD-система визуального позиционирования интерфейс защиты от электростатического разряда интерфейс подключения сканера RS-232

